SEMICON Japan通信 2026 Vol.2

半導体
これまでの50年 これからの50年

12.9（水）- 11（金）東京ビッグサイトにて開催

SEMICON Japan 2026
来場登録受付中！

来場登録はこちら

Early Bird 早割受付中！注目セミナーPick Up



半導体の最先端技術から製造プロセス、材料、国際EHS規制まで。
SEMICON Japan 2026では、業界のエキスパートから専門知識と最新動向を学べる有料セミナーを開催します。
今ならEarly Bird早割価格・ぜひこの機会にお申し込みください。

SEMI テクノロジーシンポジウム（STS）

半導体製造技術の最前線を、短期集中で総覧

AIのさらなる進化を支える、先端半導体技術の最新動向を深く学ぶ「SEMI Technology Symposium（STS）」・今年は「パワーデバイス」「パッケージング」「テスト」「先端デバイス・プロセス」「計測・検査」「先端リソグラフィ」の6セッションを展開します。第一線で活躍する技術者・専門家による講演を通じて、次世代AIの実現に向けたチップの開発・製造の鍵となる技術領域を横断的に捉え、半導体製造技術の現在地とこれからを探ります。

日時：2026年12月9日（水）～11日（金）
会場：東8ホール 商談室（1）・（2）および オンライン（Zoom）

Pick Up スピーカー



大村 一郎
九州工業大学



片桐 規貴
新光電気工業



小川 義宏
キオクシア



Michael Lercel
ASML

詳細はこちら

Strategic Materials Conference (SMC) Japan

半導体の進化を支える「材料」の最新動向を読み解く

Strategic Materials Conference（SMC）は、半導体の性能向上や技術革新を支える「材料」にフォーカスした専門カンファレンスです。今年は「AI・データセンター半導体を支える先端半導体材料とその進化」をテーマに開催・AIの急速な普及とデータセンター需要の拡大を背景に、先端半導体材料に求められる役割や最新技術動向、今後の課題を材料の視点から読み解きます。技術開発や事業戦略のヒントを得たい技術者、研究開発担当者、事業企画担当者におすすめのプログラムです。

日時：2026年12月8（火）10:20 - 17:15
会場：TechSTAGE FUJI（会議棟6F 607＋608）

Pick Up スピーカー



南川 明
インフォーマインテリジェンスコンサルティンググループ



山田 幹也
みずほ証券



梶本 実利
キオクシア



中村 健次
新光電気工業

詳細はこちら

国際EHS規制適合セミナー

変化する国際EHS規制を知り、グローバルな規制対応へ

半導体産業を取り巻く国際的なEHS（環境・健康・安全）規制について、最新動向や規制対応への理解を深めるセミナーです。グローバルにビジネスが展開される半導体産業では、各国・地域におけるEHS関連規制への対応が重要なテーマとなっています。国際的な規制の動きを把握し、今後の対応を考える機会として、EHS・環境・安全部門をはじめ、海外ビジネスや製品・事業に関わる方にも注目いただきたいプログラムです。

日時：2026年12月9日（水）13:00 - 17:00
会場：会議棟7階 703 および オンライン（Zoom）

Pick Up スピーカー



大下 真介
ダイキン工業



真白 すびか
国際規制適合委員会（ICRC）委員



小谷 博
Japan Business Council in Europe



鹿野 真
日立ハイテク

詳細はこちら

半導体プロセス技術セミナー 全11講座

半導体製造を支えるプロセス技術を、基礎から先端まで。

本セミナーシリーズでは、前工程・後工程の基礎から、リソグラフィ、エッチング、洗浄、さらにはイメージセンサーやパワー半導体まで、半導体製造に関わる幅広い技術を各分野の専門家がわかりやすく解説します。

若手技術者はもちろん、担当分野以外の知識を広げたい方や、半導体製造プロセスの全体像を理解したい方にもおすすめです。全11講座から、ご自身の関心や業務に合わせてお選びいただけます。

日時：2026年12月9日（水）～11日（金）
会場：会議棟7階　701-702

12月9日（水）
10:00 - 12:00　若手技術者にむけた前工程概論
13:00 - 16:00　半導体プロセス技術「リソグラフィ」

12月10日（木）
09:30 - 11:00　半導体技術 特別編「イメージセンサー」
11:20 - 12:50　半導体プロセス技術「平坦化」
13:10 - 14:40　半導体プロセス技術「洗浄」
15:00 - 17:00　半導体プロセス技術「拡散・注入」

12月11日（金）
09:30 - 11:50　半導体プロセス技術「ドライエッチング」
10:00 - 13:30　若手技術者にむけた後工程概論I
12:10 - 14:40　半導体プロセス技術「多層配線」
14:00 - 17:00　若手技術者にむけた後工程概論II
15:00 - 17:00　半導体技術 特別編「パワー半導体」

＼10/31まで！Early Bird 早割受付中 /

セミナー一覧を見る

SEMICON Japan 2026
そのほかの新企画も、今後順次ご紹介します。

来場登録はこちら

特集記事



ADIS 2026 半導体設計で底上げする日本の産業競争力1
AIの進化・応用拡大に向けて、日本の半導体設計力に期待されていること

SEMICON Japan 2026 スポンサー

Platinum Sponsors

DISCO　HIGHTEC SYSTEMS　HITACHI Hitachi High-Tech　SCREEN Innovation for a Sustainable World　TEL

Gold Sponsors

ADVANTEST　APPLIED MATERIALS　ASM　EBARA　FUJIFILM　JSR　KLA　KE KOKUSAI ELECTRIC　Lam RESEARCH　MJC　Nikon　Qnity　TERADYNE　ACCRETECH 東京精密

Silver Sponsors

JX金属　TOWA

Workforce Development Sponsors

HORIBA　muratec　SIMCO　TRENG

（10月14日現在、社名アルファベット順）

開催概要

半導体　これまでの50年　これからの50年

日　時：12月9日（水）- 11日（金）10:00 - 17:00
会　場：東京ビッグサイト
有明セントラルタワーホール&カンファレンス
TFTビル
費　用：展示会無料、セミナー一部有料

公式Webサイトはこちら

同時開催

ADIS Advanced Design Innovation Summit　APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit　MIS Metrology & Inspection Summit